# 3D NAND Scaling Challenges and Materials Solutions

### 초록:

2D CTF cell 개발에서 200단 이상의 양산 3D NAND에 이르기까지의 20여년의 기술적인 도전을 극복한 과정을 돌아보고, 앞으로 1000단 이상의 3D NAND를 향한 기술적인 과제와 극복을 위한 시도들을 소개한다.

# **Biography**

# **Chang Seok Kang**

Senior Director, Applied Materials changseok\_kang@amat.com

#### Education

PhD: Electrical and Computer Engineering, University of Texas at Austin (2004) Master/Bachelor: Material Science, Seoul National University (1989/1991)

## **Experience**

Applied Materials: 2018~Present (Memory Integration) Samsung Electronics: 1991~2018 (DRAM, CTF NAND)

### **Publication**

Holds 120+ US patents and ~70 international publications.

Link https://www.linkedin.com/in/chang-seok-steve-kang-8a4735142/